

 Smart Sensing 2025

 **SEMISOL 2025**
半導体後工程技術&ソリューション展

2025年6月18日(水)～20日(金)10:00-17:00 東京ビッグサイト東8ホール

開催報告書

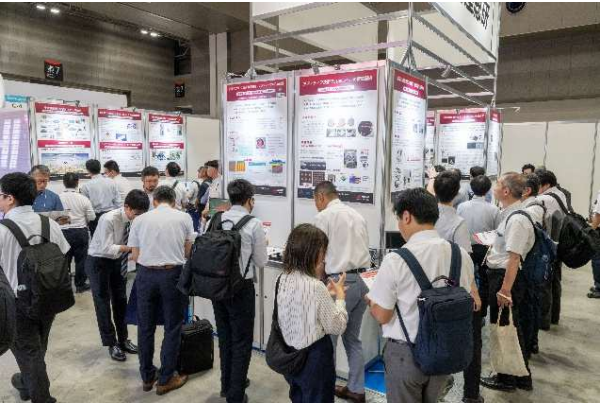
主催

Jtb Communication Design

想像を超えた、創造を。Best Solution, Best Partner.

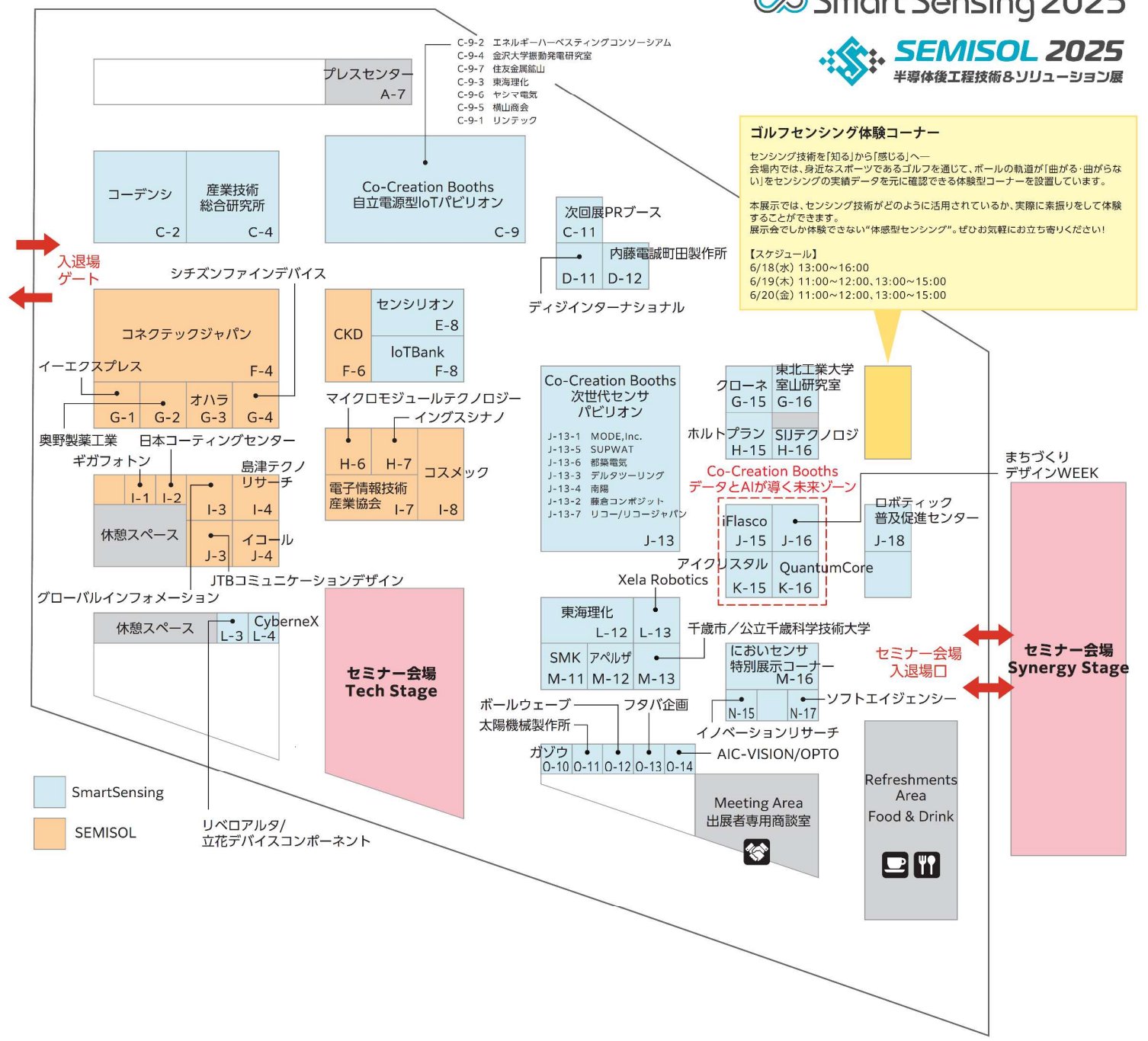
名 称	 Smart Sensing 2025  SEMISOL 2025 半導体後工程技術&ソリューション展
会 期 会 場	2025年6月18日(水)～6月20日(金)10:00-17:00 東京ビッグサイト東8ホール
主 催	株式会社JTBコミュニケーションデザイン
展示規模	Smart Sensing:49社 59小間(共同出展者含む) SEMISOL:15社25小間
メディア パートナー	   

来場実績	来場参加者数		
	5,270 名		
	開催日	天候	来場者数
	6月18日(水)		1,460名
	6月19日(木)		1,849名
	6月20日(金)		1,961名



※法人格省略

	出展者名	小間番号	展示会名
あ	IoTBank	F-8	Smart Sensing
	アイクリスタル	K-15	Smart Sensing
	iFlasco	J-15	Smart Sensing
	アベルザ	M-12	Smart Sensing
	イーエクスプレス	G-1	SEMISOL
	イコール	J-4	SEMISOL
	イノベーションリサーチ	N-15	Smart Sensing
	インクスシナノ	H-7	SEMISOL
	AIC-VISION	O-14	Smart Sensing
	OPTO	O-14	Smart Sensing
	SUJ テクノロジ	H-16	Smart Sensing
	SMK	M-11	Smart Sensing
	エネルギーハーベスティングコンソーシアム	C-9-2	Smart Sensing
	奥野製薬工業	G-2	SEMISOL
	オハラ	G-3	SEMISOL
か	ガゾウ	O-10	Smart Sensing
	金沢大学振動発電研究室	C-9-4	Smart Sensing
	ギガフォトン	I-1	SEMISOL
	QuantumCore	K-16	Smart Sensing
	クローネ	G-15	Smart Sensing
	グローバルインフォメーション	I-3	SEMISOL
	コーデンシ	C-2	Smart Sensing
	コスミック	I-8	SEMISOL
	コネクテックジャパン	F-4	SEMISOL
	CyberneX	L-4	Smart Sensing
	産業技術総合研究所センシング技術研究部門	C-4	Smart Sensing
	産業技術総合研究所人間社会拡張研究部門	C-4	Smart Sensing
	CKD	F-6	SEMISOL
	シチズンファインデバイス	G-4	SEMISOL
	島津テクノリサーチ	I-4	SEMISOL
	SUPWAT	J-13-5	Smart Sensing
	住友金属鉱山	C-9-7	Smart Sensing
さ	XELA Robotics	L-13	Smart Sensing
	センシリオン	E-8	Smart Sensing
	ソフトエイジェンシー	N-17	Smart Sensing
	太陽機械製作所	O-11	Smart Sensing
	千歳市	M-13	Smart Sensing
	公立千歳科学技術大学	M-13	Smart Sensing
	都築電気	J-13-6	Smart Sensing
	デザインインターナショナル	D-11	Smart Sensing
	デルタツーリング	J-13-3	Smart Sensing
	電子情報技術産業協会	I-7	SEMISOL
	東海理化	C-9-3	Smart Sensing
	東海理化	L-12	Smart Sensing
	東北工業大学 室山研究室	G-16	Smart Sensing
	内藤電誠町田製作所	D-12	Smart Sensing
	南陽	J-13-4	Smart Sensing
	においセンサ特別展示コーナー	M-16	Smart Sensing
	日本コーティングセンター	I-2	SEMISOL
は	藤倉コンボジット	J-13-2	Smart Sensing
	フタバ企画	O-13	Smart Sensing
	ボールウェーブ	O-12	Smart Sensing
	ホルトプラン	H-15	Smart Sensing
ま	マイクロモジュールテクノロジー	H-6	SEMISOL
	まちづくりデザイン WEEK	J-16	Smart Sensing
	MODE,Inc.	J-13-1	Smart Sensing
	ヤシマ電気	C-9-6	Smart Sensing
や	横山商会	C-9-5	Smart Sensing
	リコー	J-13-7	Smart Sensing
ら	リコー	J-13-7	Smart Sensing
	リコー	J-13-7	Smart Sensing
	リベロアルタ	L-3	Smart Sensing
	立花デバイスコンポーネント	L-3	Smart Sensing
	リンテック	C-9-1	Smart Sensing
	ロボティック普及促進センター	J-18	Smart Sensing



Smart Sensing 2025



ゴルフセンシング体験コーナー

センシング技術を「知る」から「感じる」へー
会場内では、身近なスポーツであるゴルフを通じて、ボールの軌道が「曲がる・曲がらない」をセンシングの実績データを元に確認できる体験型コーナーを設置しています。

本展示では、センシング技術がどのように活用されているか、実際に素振りをして体験することができます。
展示会でしか体験できない“体感型センシング”。ぜひお気軽にお立ち寄りください！

【スケジュール】
6/18(水) 13:00~16:00
6/19(木) 11:00~12:00, 13:00~15:00
6/20(金) 11:00~12:00, 13:00~15:00

**セミナー会場
Synergy Stage**

**Refreshments
Area
Food & Drink**

**Co-Creation Booths
データとAIが導く未来ゾーン**

iFlasco J-15 J-16
QuantumCore K-15 K-16

**Co-Creation Booths
次世代センサパビリオン**

J-13-1 MODE,Inc.
J-13-5 SUPWAT
J-13-6 都築電気
J-13-3 デルタツーリング
J-13-4 南陽
J-13-2 藤倉コンボジット
J-13-7 リコー/リコージャパン

**マイクロモジュールテクノロジー
パビリオン**

H-6 H-7 H-8
電子情報技術産業協会 I-7 I-8

コネクテックジャパン

イーエクスプレス F-4
オハラ G-1 G-2 G-3 G-4
ギガフォトン I-1 I-2
島津テクノリサーチ I-3 I-4
休憩スペース J-3 J-4
イコール J-4

グローバルインフォメーション

休憩スペース L-3 L-4
CyberneX

**セミナー会場
Tech Stage**

**リベロアルタ/
立花デバイスコンポーネント**

**ボールウェーブ
太陽機械製作所**

ガゾウ O-10 O-11 O-12 O-13 O-14

**においセンサ
特別展示コーナー**

M-15 M-16
ソフトエイジェンシー N-15 N-17

東海理化

L-12 L-13
SMK M-11 M-12 M-13
アベルザ

ホルトプラン

H-15 H-16
クロネ G-15 G-16
東北工業大学 室山研究室

**Co-Creation Booths
次世代センサパビリオン**

J-13-1 MODE,Inc.
J-13-5 SUPWAT
J-13-6 都築電気
J-13-3 デルタツーリング
J-13-4 南陽
J-13-2 藤倉コンボジット
J-13-7 リコー/リコージャパン

次回展PRブース

C-11 C-12
内藤電誠町田製作所

**Co-Creation Booths
自立電源型IoTパビリオン**

C-9-2 エネルギーハーベスティングコンソーシアム
C-9-4 金沢大学振動発電研究室
C-9-7 住友金属鉱山
C-9-3 東海理化
C-9-6 ヤシマ電気
C-9-5 横山商会
C-9-1 リンテック

プレスセンター

A-7

コーデンシ

C-2 C-4

シチズンファインデバイス

入退場ゲート

コネクテックジャパン

イーエクスプレス

オハラ

ギガフォトン

島津テクノリサーチ

休憩スペース

イコール

JTBコミュニケーションデザイン

グローバルインフォメーション

休憩スペース

CyberneX

**リベロアルタ/
立花デバイスコンポーネント**

スマートセンシング

SEMISOL

スマートセンシング

SEMISOL

スマートセンシング

SEMISOL

スマートセンシング

SEMISOL

スマートセンシング

SEMISOL

Co-Creation Booths:次世代センサパビリオン

本パビリオンでは、センシング技術の多様化・高度化が進む中、研究開発から製品化・実装へとつながる技術を広く紹介し、来場者にとって新たな発見と企業間連携の場を創出することを目的に、次世代のセンシング技術やIoT社会を支えるセンサ焦点を当てたゾーンとして実施しました。

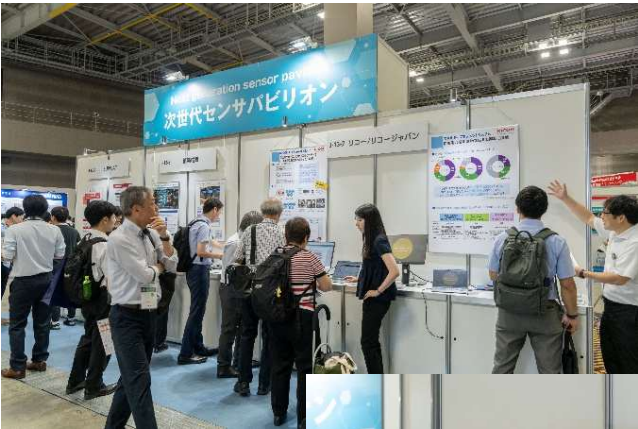
次世代センシング分野で先進的な取り組みを行う出展者が一堂に会し、それぞれの強みや技術シーズを披露し、センシングによる社会課題解決や、新市場創出の可能性に関心を寄せる多くの来場者が立ち寄り、活発な意見交換や商談が行われました。

■次世代センサパビリオン出展者:

MODE Inc. / 藤倉コンポジット / デルタツーリング / 南陽 / SUPWAT / リコー・リコージャパン / 都築電気

■次世代センサパビリオン内 ピッチステージ:

講演日時	6月18日	6月19日	6月20日
13:30-13:50	MODE 現場の未来を拓く - AIで挑む「8掛け社会」 -	リコー/リコージャパン 「室内環境の見える化と省エネの提案 ～快適性とCO2削減の両立～」	南陽 センシングによる ワイヤボンド検査システム
14:00-14:20	デルタツーリング 非侵襲型APWセンサーおよび アプリケーションのご紹介	デルタツーリング 非侵襲型APWセンサーおよび アプリケーションのご紹介	リコー/リコージャパン 「室内環境の見える化と省エネの提案 ～快適性とCO2削減の両立～」
14:30-14:50	リコー/リコージャパン 「室内環境の見える化と省エネの提案 ～快適性とCO2削減の両立～」	MODE 現場の未来を拓く - AIで挑む「8掛け社会」 -	藤倉コンポジット バッテリーレス液体検知センサ紹介
15:00-15:20	藤倉コンポジット バッテリーレス液体検知センサ紹介	藤倉コンポジット バッテリーレス液体検知センサ紹介	MODE 現場の未来を拓く - AIで挑む「8掛け社会」 -
15:30-15:50	—	—	デルタツーリング 非侵襲型APWセンサーおよび アプリケーションのご紹介



Co-Creation Booths:自立電源型IoTパビリオン

本パビリオンは、「自立電源型IoT」に焦点を当てた企画ゾーンとして実施しました。

振動発電デバイス、熱電モジュール、磁歪合金単結晶、エネルギーハーベスティング技術を活用した自立電源型IoTシステムなどが一堂に展示され、環境発電技術の最先端に触れ、産学官並びに企業間のオープンイノベーションを促進する場になりました。

製品開発や実用化事例など、参画企業・大学が各技術のデモやシステム構築例、バッテリーレスIoTの社会実装に向けた最新の取り組みなどを紹介する場となりました。

■出展者:

金沢大学振動発電研究室 / 住友金属鉱山 / ヤシマ電気 / 横山商会 / エネルギーハーベスティングコンソーシアム / リンテック / 東海理化

■併催セミナー:

センサー×振動発電:バッテリーレスIoTの社会実装に向けて

6月19日(木)11:20 - 12:10

金沢大学 先端科学・社会共創推進機構 特任助教

北 翔太 氏

住友金属鉱山株式会社 技術本部 材料研究所 主任研究員 泉 聖志 氏

ヤシマ電気株式会社 営業課長 佐藤 友昭 氏

株式会社横山商会 開発部開発1課 吉崎 佑 氏



Co-Creation Booths:データとAIが導く未来ゾーン

データとAIが導く未来ゾーンは、センサから取得される知能化データとAIの融合によって、新たな社会システムや革新的サービスの創出を目指す場として、今回初めて実施しました。

具体的には、プロセスインフォマティクスを活用したデジタルツイン技術による工程最適化や、調査AIによる情報探索の高度化など、出展者ごとの先進技術や取り組みが展示され、来場者は、具体的なユースケースに基づいてデータ活用・AI導入の可能性を直接体験し、会場では活発な商談が行われていました。

■出展者:

アイクリスタル：プロセスインフォマティクスによる工程最適化の紹介

iFlasco：独自の調査AI「AIFlasco」を活用した調査サービス

QuantumCore：インターネット一切不要のエッジ学習が可能なリザバーコンピューティングを活用したエッジAIソリューションの紹介

■出展者プレゼンテーション:

半導体製造におけるデジタルツインとプロセスインフォマティクス

6月20日(金)13:00 - 13:30

アイクリスタル

高石 将輝 氏



※法人格省略

6/18 (水)	10:15-11:05	【基調講演】半導体3D集積とチップレットの研究開発動向 横浜国立大学 准教授 半導体量子集積エレクトロニクス研究センター 副センター長 井上 史大 氏	聴講者数 2位
	14:05-14:55	手指動作センシング技術の開発と人・次世代ロボットへの応用 東北工業大学 工学部 電気電子工学科 教授 博士(工学) / 東北大学 大学院工学研究科ロボティクス専攻 客員教授 / レイセンス 共同創業者・取締役・最高技術責任者 室山 真徳 氏	
6/19 (木)	10:15-11:05	最新の世界半導体状況と、日本の未来への課題 国際技術ジャーナリスト News & Chips編集長、セミコンポータル編集長 津田 建二 氏	聴講者数 3位
	11:20-12:10	先端半導体の工法革新を支える Sensing & Control技術 オムロン インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー セミコンダクタ&インキュベーションセンター センター長 金田 哲郎 氏	
	13:30-17:00	エッジAI半導体を創る後工程技術	聴講者数 1位
	13:30-14:00	【基調講演】日本政府の半導体産業支援戦略 経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 デバイス・半導体戦略室 室長 清水 英路 氏	
	14:00-14:30	特別講演「ASRAによるチップレット先端半導体の車載化について」 自動車用先端SoC 技術研究組合 専務理事 川原 伸章 氏	
	14:30-15:00	特別講演「SATAS活動内容のご紹介」 半導体後工程自動化・標準化技術研究組合 理事長 / 元インテル 代表取締役会長 鈴木 国正 氏	
	15:00-15:20	休憩	
	15:20-15:40	国内OSAT企業の業界団体の紹介 日本 OSAT 連合会 事務局長 林 力 氏	
	15:40-16:00	3D積層型CMOSイメージセンサの進化と将来 ソニーセミコンダクタソリューションズ 研究開発センター 副センター長 岩元 勇人 氏	
	16:00-16:20	先端パネルレベルパッケージの開発トレンド(AI向け電源~chiplet集積) アイ電子 先端パッケージ推進本部 取締役 先端パッケージ推進本部長 相沢 吉昭 氏	
	16:20-16:40	エッジAI半導体後工程開拓に向けて 大阪大学産業科学研究所 フレキシブル 3D 実装協働研究所 特任教授 所長 菅沼 克昭 氏	
	16:40-17:00	質疑応答	
6/20 (金)	10:30-11:30	【においセンサ パネルディスカッション】 AIはニオイセンサの救世主となりえるのか? モデレーター:物質・材料研究機構 機能性材料研究拠点 グループリーダー 吉川 元起 氏 パネリスト:Qception 代表取締役 今村 岳 氏 コニカミノルタ 技術開発本部 研究戦略センター 企画推進部 部長 秋山 博 氏 におい科学研究所 代表 喜多 純一 氏	
	12:45-13:35	スマートセンシングによるKIBS創出に向けたデータ戦略・標準戦略 ※本講演はオンライン配信の予定です。ご聴講はセミナー会場でのみとなります。 産業技術総合研究所 フェロー 持丸 正明 氏	
	13:50-14:40	AI・チップレット等先端半導体パッケージング構造設計と標準化の現状と課題 JEITA 半導体構造設計技術サブコミティ / 大阪大学 吉田 浩芳 氏	
	15:00-16:00	リアルワールドビッグデータを活用した人と共進化する人工知能技術 ~リフレクションとリフレームを促進するモデリング~ 産業技術総合研究所 人工知能研究センター首席研究員 人工知能技術コンソーシアム 会長 / 人工知能学会 副会長 本村 陽一 氏	

■ Synergy Stage

実施講演数:15本

聴講者数:1,328名

Synergy Stageでは、基調講演を含む半導体の3D積層・チップレット研究開発、手指動作センシング技術やロボティクス応用、最新の世界半導体情勢の分析、エッジAIの後工程設計といったテーマを取り上げ、各テーマの有識者の方々にご登壇いただきました。

19日の午後は、エッジAI半導体を創る後工程技術というテーマで、経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 デバイス・半導体戦略室 室長 清水 英路様をお招きし、日本政府の半導体産業における支援・戦略に関しご講演いただきました。



※法人格省略

6/18 (水)	11:20-12:10	チップレット実装の未来を拓くOSRDA コネクテックジャパン 代表取締役 会長 平田 勝則 氏	聴講者数:1位
	14:00-14:45	注目のTSV/RDL コネクテックジャパンの挑戦 コネクテックジャパン 取締役 専務執行役員 下石坂 望 氏 コネクテックジャパン 先端開発部長 小松 裕司 氏	聴講者数:2位
	15:00-15:30	波長193nmの深紫外光を使った難加工材のレーザ加工のご紹介 ギガフォトン 研究開発本部 研究部 担当部長 三浦 泰祐 氏	
6/19 (木)	11:20-12:10	センサー×振動発電:バッテリーレスIoTの社会実装に向けて 金沢大学 先端科学・社会共創推進機構 特任助教 北 翔太 氏 住友金属鉱山 技術本部 材料研究所 主任研究員 泉 聖志 氏 ヤシマ電気 営業課長 佐藤 友昭 氏 横山商会 開発部開発1課 吉崎 佑 氏	
	13:00-13:15	スーパーインクジェット技術のご紹介とセンサデバイスにおける活用事例 SIJテクノロジー 開発・営業部 マネージャー 清水 康太郎 氏	
	14:00-14:45	センシング向けマルチプロトコル対応XBee無線通信デバイス ~LTE、LPWA、920/900/868MHz、2.4GHz、メッシュ~ Digi International 江川 将峰 氏	
6/20 (金)	15:00-15:45	生産現場でのAI外観検査、協働ロボット、搬送システムの導入支援に特化した「ロボット・セカンドオピニオンサービス」 ロボティック普及促進センター 理事長 小林 賢一 氏	
	10:30-10:45	スーパーインクジェット技術のご紹介とセンサデバイスにおける活用事例 SIJテクノロジー 開発・営業部 マネージャー 田代 直樹 氏	
	11:30-12:00	半導体後工程プロセスを支えるオハラの光学材料 オハラ 半導体拡販タスクチーム タスクチームリーダー 小俣 慶彦 氏	
	12:15-12:45	安物買いのXX失い!? 実録・センサー失敗集「それ、カタログ通りに動くと思ってた?」 リベロアルタ 木本 彰 氏	
	13:00-13:30	半導体製造におけるデジタルツインとプロセスインフォーマティクス アイクリスタル 高石 将輝 氏	
	14:00-14:50	急成長する生成AI時代のセンサービジネス - 儲からないIoTに終止符を - MODE Inc. Vice President of Business 上野 聡志 氏	聴講者数:3位
	15:15-16:15	CES2025で見てきたAIの未来と日本への追い風 日本政策投資銀行 設備投資研究所 主任研究員 青木 崇 氏 Ozplus 代表取締役社長 小野 あい 氏	

■Tech Stage
実施講演数:15本
聴講者数:891名

Tech Stageは、企業プレゼンテーションを中心に開催。
チップレット実装やTSV/RDLといった先端半導体技術から、バッテリーレスIoTの社会実装を支える振動発電や、スーパーインクジェット応用事例、急成長する生成AI時代のセンサービジネスなど、多岐にわたるテーマで各企業・団体が講演・プレゼンテーションを行いました。



ゴルフセンシング体験コーナー/Innovators' Networking

■ゴルフセンシング体験コーナー Supported by 東北工業大学

センシングをどのように行っていくか？

身近なスポーツであるゴルフを行いながら、『ボールが曲がる？曲がらない？』をセンシングの実績データを元に確認できる体験コーナーを、東北工業大学様の企画協力のもと、展示会場内に設置いたしました。センシング技術がどのように活用されているか、来場者に実際に素振りをして体験いただきました。

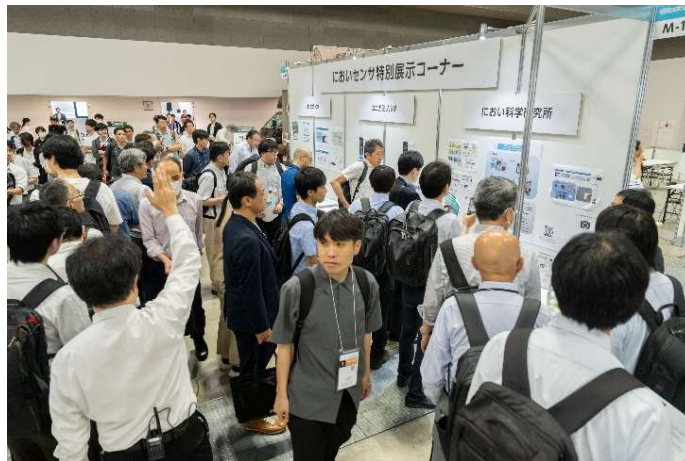
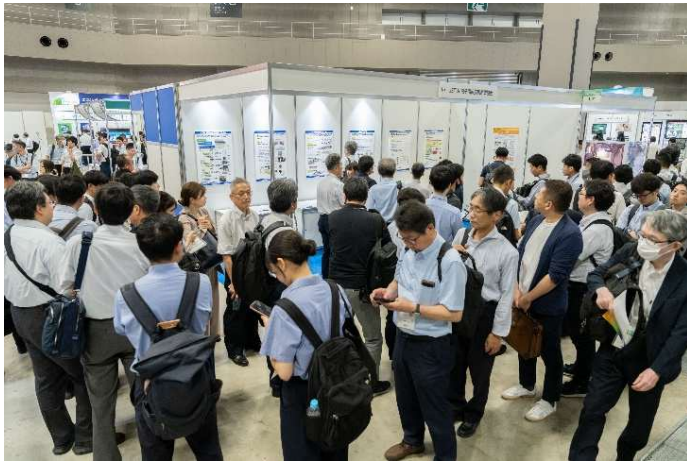
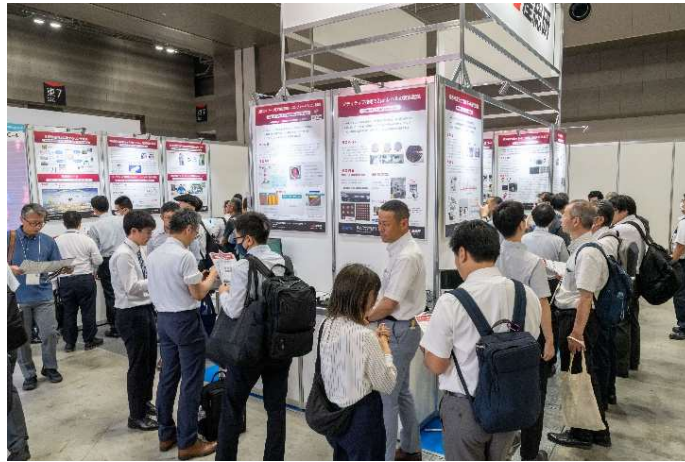
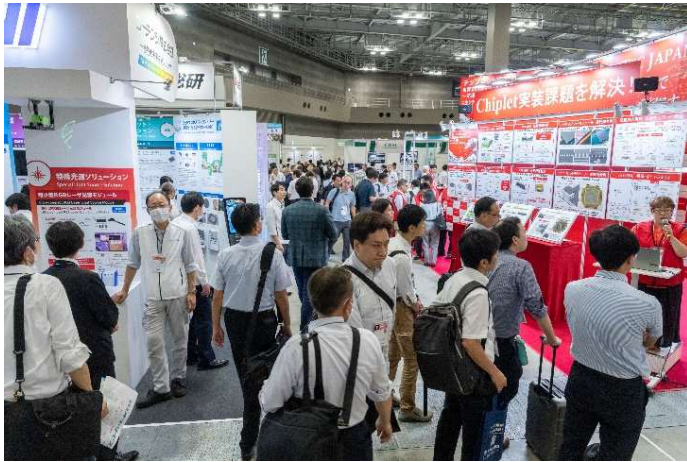


■Innovators' Networking

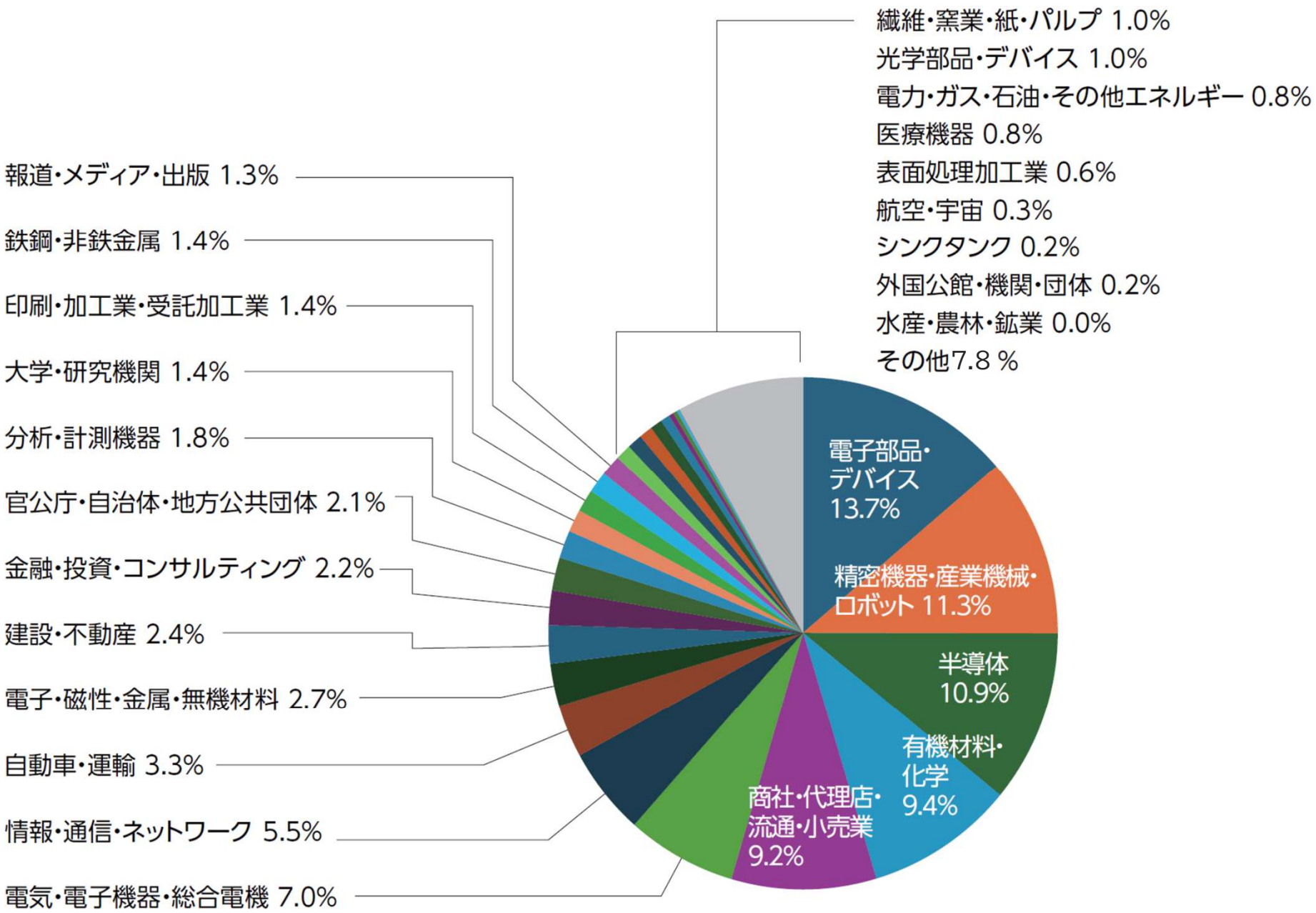
会期2日目の19日(木)には出展者、来場者、講演者の交流の場 "Innovators' Networking" を展示会場内で開催いたしました。様々な業種、職種が集まり、気軽に交流できるネットワーキングを通じて、本展示会でしか出会えない人と人、組織と組織の交流機会となりました。



展示会ハイライト

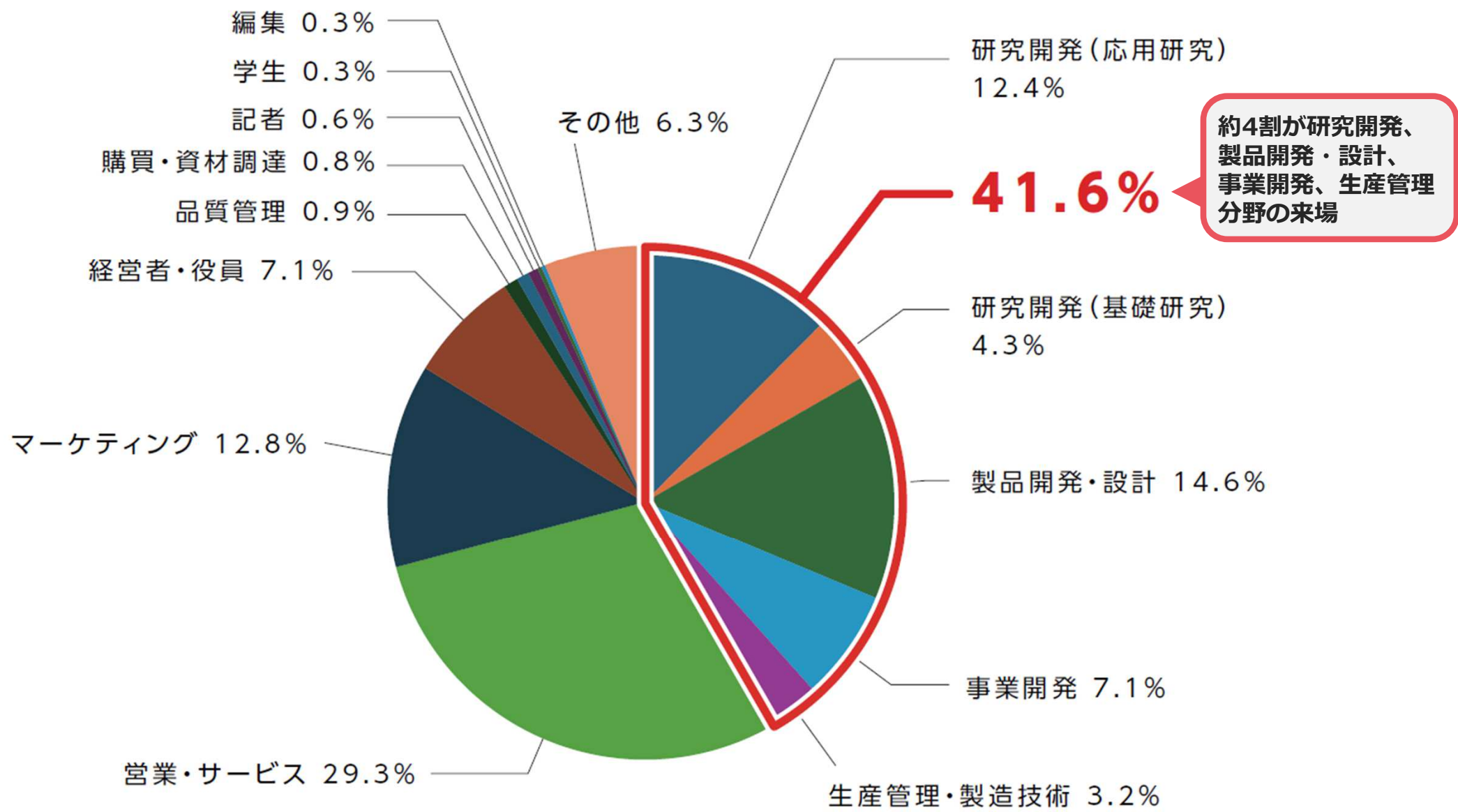


来場者登録時アンケート「来場者業種」



※Smart Sensing/SEMSOL 来場登録アンケートより集計
N=7218

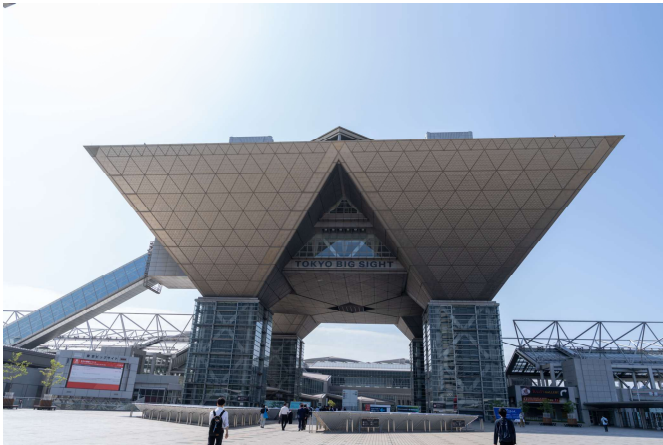
来場者登録時アンケート「来場者職種」



※Smart Sensing/SEMSOL 来場登録アンケートより集計
N=7218

センシング・半導体後工程で次の未来を創る
先端技術が連携する、次のビジネスに発展する、そして参加者同士がボーダレスにつながる展示会へ

2026年6月10日(水)～12日(金)10:00～17:00
東京ビッグサイト 西3ホール



▼出展料

出展種別	早期割引 / 通常	期間	出展料 (税込)
スペースのみ (9m ²) 出展	早期割引	2026年1月31日まで	¥396,880
	通常料金	2026年2月1日以降	¥496,100
スペースのみ (9m ²) 出展 独法/大学/ベンチャー	早期割引	2026年1月31日まで	¥237,600
	通常料金	2026年2月1日以降	¥286,000
付帯備品付き (4m ²) 出展	通常料金	全期間適用	¥242,000

▼ご出展に関するご相談等はお気軽にお問合せください

Smart Sensing/SEMISOL 事務局
(株)JTBコミュニケーションデザイン
〒105-8335 東京都港区芝3-23-1
セレスティン芝三井ビルディング
E-mail:smartsensing@jtbcom.co.jp

公式ウェブサイト

